

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 3

TABELA 1

<p style="text-align: center;">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p> <p style="text-align: center;">MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE</p>	<p style="text-align: center;">POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</p>
1	2
Serwer – 1 szt.	
<p>1) Płyta główna: wyposażona w min. 6xPCI-E 4.0 x16, 1 x 1 PCI-E 4.0 x8, min. 2 x M.2 PCI-E 4.0 x4, RAID 0 & 1 Form Factor: 2242/2260/2280/22110, min. 6 złącz DIMM, min. 10 gniazd SATA III ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0,1,5,10, moduł TPM; interfejs IPMI 2.0, obsługa min. 2 CPU i min. 38 rdzeni na CPU, pozwalająca na równoległy montaż 4 kart GPU podwójnej wysokości w czterech slotach PCIe 4.0x16, kompatybilna z jednostką obliczeniową GPU –opisaną w pkt. 4);</p> <p>2) Chipset: dostosowany do oferowanego procesora;</p> <p>3) Procesor: min. 1x dwudziestordzeniowy / czterdziestowątkowy klasy x86/x64, wspierający wirtualizację oraz równoległą pracę w zespole wieloprocesorowym, min. bazowa częstotliwość taktowania 2.30GHZ, min. częstotliwość taktowania w trybie turbo: 3.5 GHZ, minimalna przepustowość UPI: 11.2GT/s, nie gorszej klasy niż Intel Xeon Gold 5320T;</p> <p>4) Jednostka obliczeniowa GPU: pamięć min. 80GB HBM2e, slot PCIe, moc obliczeniowa FP64 min. 9.7 TFLOPS, FP64 Tensor Core min. 19.5 TFLOPS, FP32 min. 19.5 TFLOPS, Tensor Float 32 (TF32) min. 156 TFLOPS, BFLOAT16 Tensor Core min. 312 TFLOPS, FP16 Tensor Core min. 312 TFLOPS, INT8 Tensor Core min. 624 TOPS klasy nie gorszej niż NVIDIA A 100;</p> <p>5) Pamięć RAM: min. 512GB DDR4 3200 MHz, możliwość rozbudowy do min 4TB;</p> <p>6) Dysk twardy: min. 2x 1 TB SSD NVMe + min. 3TB HDD;</p> <p>7) Karta graficzna: Karta grafiki niezintegrowana z płytą główną;</p> <p>8) Karta sieciowa: Zintegrowana 2x RJ45 10GbE BaseT, Zintegrowany 1x port IPMI;</p> <p>9) Porty: VGA, min. 10x USB 3.1 Gen1, min. 2 USB 2.0;</p> <p>10) Obudowa z zasilaczem: Typu Tower 4U z opcją montażu w szafie serwerowej (minimum 3 wnęki zewnętrzne 5,25”, min. 1 wnoka wewnętrzne 3,5” i min. 4x wnęki zewnętrzne Hot-swap SAS3/SATA3 i min. 4x wnęki zewnętrzne Hot-swap NVMe/SAS3/SATA3 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych), obudowa musi być wyposażona w 2 redundantne zasilacze typu hot-swap, o mocy min 2200W każdy; Obudowa musi być wyposażona w system chłodzący składający się z min. 4 zintegrowanych wentylatorów; Obudowa musi posiadać możliwość montażu 4 kart GPU podwójnej wysokości w czterech slotach PCIe 4.0x16;</p> <p>11) Kompatybilność: W celu uniknięcia błędów kompatybilności Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać modyfikacji konfiguracji</p>	TAK

producenta sprzętu.

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie Części 3							
Poz.	Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ i jeżeli istnieje odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu	Ilość	Cena jednostkowa Netto [w PLN]	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) [w PLN]	Stawka VAT	Wartość brutto (war- tość netto + wartość VAT) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Serwer	Stacja robocza	1 szt.			0%	
		Procesor:					
		Karta graficzna:					
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do formularza OFERTA)							

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.